



台積公司宣佈第五大開放創新平台聯盟啓動－雲端聯盟

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2018年10月3日

台灣積體電路製造股份有限公司今（3）日在北美開放創新平台（Open Innovation Platform[®], OIP）生態環境論壇宣佈成立第五大 OIP 聯盟－雲端聯盟（Cloud Alliance）。創始成員亞馬遜雲端服務（AWS）、益華國際電腦科技（Cadence）、微軟 Azure（Microsoft Azure）以及新思科技（Synopsys）與台積公司合作，在雲端上共同提供經過台積公司認證的 RTL-to-GDSII 的數位設計以及 schematic capture-to-GDSII 的客製化設計能力。其中 Cadence 以及 Synopsys 各自經營虛擬店面以直接服務客戶，提供建構在 AWS 與 Microsoft Azure 雲端架構上的晶片設計解決方案。

關於 OIP 雲端聯盟

台積公司的開放創新平台共有五個聯盟：電子設計自動化聯盟（EDA Alliance）、矽智財聯盟（IP Alliance）、設計中心聯盟（Design Center Alliance）、Value Chain Aggregator 聯盟（VCA Alliance），以及新成立的雲端聯盟（Cloud Alliance）。雲端聯盟成員與台積公司合作認證，使傳統的晶片設計自動化流程服務可運行於雲端環境上供客戶使用。

台積公司技術發展副總經理侯永清表示：「台積公司對於整個雲端的趨勢感到振奮。我們不只在公司內部採用雲端處理先進製程設計上所需的大量高速運算，更進一步和 OIP 雲端聯盟夥伴 AWS、Cadence、Microsoft Azure 以及 Synopsys 合作開發 OIP 虛擬設計環境（Virtual Design Environment, VDE），降低我們共同客戶進入雲端的門檻。我們提供的雲端解決方案除了可以執行系統晶片設計所需的大量批次化運算，更確保了例如客製化晶片佈局等高度互動性的設計工作能夠在雲端上順暢地執行。我們與夥伴共同努力，在符合產品實戰要求的高強度環境底下進行雲端解決方案的認證工作，使得客戶的晶片設計生產力藉由採用雲端的強大運算能力以及彈性而進一步提升。」

Cadence 總裁 Anirudh Devgan 表示：「Cadence 帶給雲端聯盟支援客戶設計環境以及利用雲端完成工程專案的經驗已超過十年。做為台積公司第一個與共同客戶接觸的聯盟夥伴，我們已見證了成功的雲端設計定案，也同時正積極的與其他客戶合作，利用雲端的彈性在緊湊的時間表內完成系統晶片設計。通過與台積公司的緊密合作，我們提供客戶快速並具有擴充性的方式在雲端使用 Cadence 的工具與流程以及台積的矽智財。」

Synopsys 設計事業群共同總經理 Deirdre Hanford 表示：「Synopsys 成為台積公司電子設計自動化及矽智財 OIP 夥伴已經進入第 11 年了，如今我們與台積的夥伴關係將擴展至雲端上的晶片設計。我們與 AWS 以及 Microsoft Azure 合作，一同為台積 VDE 提供一個安全而且流暢的設計流程。Synopsys Cloud Solution 的安全與效能通過了台積公司的嚴格要求，並已準備好讓客戶在雲端中使用台積公司的晶片設計輔助資料檔與 Synopsys 的工具與矽智財進行晶片設計。」

微軟 Azure 硬體基礎工程部總經理及傑出工程師 Kushagra Vaid 表示：「Microsoft Azure 非常高興成為台積公司 OIP 雲端聯盟創始成員，同時也很榮幸，因為我們共



同開發 VDE 雲端解決方案的努力而成爲 2018 年度夥伴獎得主之一。我們期盼在與台積公司的緊密合作之下,看到更多的先進晶片設計採用 Azure 雲端平台進行開發。」

關於台積公司

台積公司 (TSMC) 是全球最大的專業積體電路製造服務公司,提供業界卓越的製程技術、元件資料庫、設計參考流程及其他先進的晶圓製造服務。於二零一八年,台積公司預計提供超過 1,200 萬片之十二吋約當晶圓的產能,其中包括座落於台灣的三座先進的 GIGAFAB® 十二吋晶圓廠 (晶圓十二廠、晶圓十四廠及晶圓十五廠)、四座八吋晶圓廠 (晶圓三、五、六及八廠)、一座六吋晶圓廠(晶圓二廠)。此外,台積公司亦有來自其百分之百轉投資子公司美國 WaferTech 公司、台積電(中國)有限公司、台積電(南京)有限公司充沛的產能支持。台積公司係首家提供 7 奈米製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於臺灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 www.tsmc.com.tw 查詢。

#

台積公司發言人：
何麗梅
資深副總經理暨財務長
Tel:03-505-4602

台積公司代理發言人：
孫又文
企業訊息處資深處長
Tel: 03-568-2085
Mobile: 0988-937-999
E-Mail: elizabeth_sun@tsmc.com

台積公司新聞連絡人：
孔培德
公共關係部專案副理
Tel: 03-563-6688 ext. 7126216
Mobile: 0926-026-632
E-Mail: pdkramer@tsmc.com